

第5回センシングシステムシンポジウム  
および 2023年度第3回FIoTコンソーシアム研究会

『グリーントランスフォーメーションに挑むセンシング・半導体技術』プログラム

開催日時 2023年11月30日(木) 10:00~17:00

開催場所 秋葉原駅周辺(会場情報は後日ご案内致します)

開催方式 現地参加+オンライン参加のハイブリッド

**【概要・趣旨】**

20世紀末より地球温暖化対策の議論がなされる中、近年は「SDGs(Sustainable Development Goals)」やCN(カーボンニュートラル)等へ向けた動きが国際的に活発化しており、これまでとは異なる経済・産業・社会構造への改革として、GX(グリーントランスフォーメーション)に向けた各種プロジェクトが推進されつつあります。

本シンポジウムでは、GX達成に挑戦するセンシング技術と半導体関連技術に焦点を絞り、政策や最新技術動向、最先端の研究開発動向等について紹介するとともに、我が国が目指す社会の未来像や解決すべき課題等について議論、および情報共有を図ります。

司会：山田浩志

10:00~10:05 「開会挨拶」

産総研 エレクトロニクス・製造領域 副領域長 中野 隆志

10:05~10:20

「センシングシステム研究センターの取り組み(仮)」

産総研 センシングシステム研究センター 研究センター長 植村 聖

**セッション1: 【 GXに係る政策と戦略 】**

10:20~11:05 (講演40分+質疑5分)

「経済産業省のGXに係る半導体・デジタル戦略について(仮)」

経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室 室長 清水 英路 様

11:05~11:50 (講演40分+質疑5分)

「GXに向けた半導体製造技術の戦略」

名古屋大学 低温プラズマ科学研究センター 特任教授 堀 勝 様

**【 企業展示会 】**

11:50~13:50 お昼休み & 会員企業展示会 (※展示会場には軽食をご用意致します)

※出展する会員企業展示会の内容につきましては、別紙をご参照ください。

## セッション2: 【 GXに係る半導体関連技術 】

司会: 秋山 守人

13:50~14:25(講演30分+質疑5分)

「グリーン化に資する半導体後工程とパッケージ技術」

横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授 井上 史大 様

14:25~15:00(講演30分+質疑5分)

「半導体の変種変量製造に向けたプロセス制御・システム・装置ネットワーキング」

産総研 センシングシステム研究センター 研究チーム長 来見田 淳也

15:00~15:10 休憩時間

## セッション3: 【 GXに係るセンシング技術 】

司会: 田原 竜夫

15:10~15:45(講演30分+質疑5分)

「省電力と快適性・生産性向上に向けた空気環境計測技術」

三菱電機(株) 先端技術総合研究所 中井 賢也 様

15:45~16:20(講演30分+質疑5分)

「農学から発信される分光計測」(オンライン)

名古屋大学 大学院生命農学研究科 教授 土川 覚 様

16:20~16:55 (講演30分+質疑5分)

「日本の2050年カーボンニュートラル実現に向けたシナリオ分析」

産総研 ゼロエミッション国際共同研究センター 主任研究員 小澤 暁人 様

16:55~17:00 「閉会挨拶」

産総研 センシングシステム研究センター 副研究センター長 福田 伸子

※プログラムは変更する可能性があります。

※このシンポジウムの開催に関して収集した個人情報は次年度のシンポジウムの案内ほか、コンソーシアム活動及びセンシングシステム研究センターの広報活動に限定して活用させていただきます。

【お問い合わせ先】:

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター内  
センシングシステムシンポジウム事務局

E-mail: M-ss-official-symp-ml@aist.go.jp

第5回センシングシステムシンポジウム FIoT コンソーシアム会員企業様展示会 出展リスト

NO	社名	NO	展示タイトル
1	イノラックスジャパン株式会社	1	FHE Sensor Tag
		2	FHE Sensor Tag with OPV
2	シチズン電子株式会社	3	カスタムパッケージ 受託開発・製造
		4	パッケージ技術
		5	小型非接触温度センサ
3	伸和プリント工業株式会社	6	環境センサーシステム展示
4	日本航空電子工業株式会社	7	熱レス・低負荷での電気接続 フィルム型コネクタのご紹介
5	藤倉化成株式会社	8	伸縮センサー用導電性ペースト
		9	生体センサー用塩化銀ペースト
6	TOPPAN ホールディングス株式会社	10	ガラスコア基板への部品内蔵技術
		11	調光デバイス高分子分散型液晶リバーズブラック (RB-PDLC)
7	JX 金属株式会社	12	プリントエレクトロニクス微細配線用 銅インク
8	ニューロング精密工業株式会社	13	スクリーン印刷法で作製するセンサー
9	ユアサシステム機器株式会社	14	耐久試験システム